산업통상자원부 MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

보 도 자 료

희망의 대한민국 http://www.motie.go.kr

2014년 10월 24일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의: 전자부품과 김정화 과장(044-203-4270), 노승구 사무관(4275)

반도체, 끊임없는 도전과 혁신, 상생으로 대한민국 제조업의 미래를 이끈다.

- 제7회 반도체의 날을 맞아 반도체 업계의 상생협력모델인 「패턴웨이퍼 지원 프로그램」 출범 -

1 제7회 『반도체의 날』 기념식 개최

□ 대한민국 수출과 투자 1위 품목이며 국가 경제를 주도하고 있는 반도체 산업의 성과와 위상을 널리 홍보하고, 반도체 분야 산·학·연 관계자의 노고를 격려하는 축제와 화합의 장이 열린다.

○ '14. 10. 23.(목) 서울 여의도 63시티에서 **윤상직 산업통상자원부 장관,** 김기남 반도체산업협회장(삼성전자 사장), 박성욱 SK하이닉스 대표 등 산·학·연 관계자 500여 명이 참석한 가운데, **제7회 「반도체의 날」 기념식**이 열렸다.

○ 「반도체의 날」은 반도체 수출이 최초로 100억 불을 돌파한 1994년 10월을 기념해 2008년부터 시작했다.

□ 행사에 참석한 산·학·연 관계자들은 최근 풍부한 내수시장을 바탕으로 급성장하고 있는 중국 반도체 산업에 대해 적극적으로 대응하고, 사물인터넷(IoT), 웨어러블, 스마트 카 등 융합 신시장에 선도적 지위를 차지하자는 데 뜻을 함께하면서, 반도체 산업이 제조업 혁신에 앞장설 것을 다짐했다.

□ 한편, **산업통상자원부 윤상직 장관**은 축사를 통해 끊임없는 도전과 혁신을 통해 우리 반도체 산업이 이룬 성과를 격려하고, "대한민국 제조업 혁신을 통해 산·학·연·관이 함께 반도체 코리아의 위상을 더욱 높여 나가자."라고 강조했다.

○ 이를 위해 정부는 적극적인 투자 애로와 과감한 규제개혁, 제조업 재도약을 위한 '제조업 혁신 3.0전략' 실행대책을 마련해 대, 중, 소 협력 생태계 강화 등을 정부의 지원을 약속했다.

□ 반도체의 날을 맞아 관련 유공자에 포상도 있었다.

○ **금탑산업훈장은** 세계 최초 '3차원 V 낸드' 상용화 등 끊임없는 신제품 개발을 통해 지난 메모리 세계 1위를 지킨 **전동수 삼성SDS 대표**(전 삼성전자 사장)가 받았다.

○ 장재영 국제엘렉트릭코리아 대표가 차세대 열처리 장비개발을 통해 장비국산화율을 높이는 데 이바지한 공로로 동탑산업훈장을 받았고, 김현곤 SK하이닉스 상무가 고성능, 고용량, 저전력 모바일 D램 개발을 선도한 공을 인정받아 산업포장을 받았다.

○ 이 밖에도 대통령 표창 2명, 국무총리표창 3명, 산업통상자원부 장관 표창 28명을 포상했다.

< 반도체 산업발전 정부포상 대상자 >

구 분	훈 격		규모	비 고
정부 포상 (36점)	산업 훈장	금탑	1	전동수 대표(삼성SDS 대표, 前 삼성전자 사장)
		동탑	1	장재영 대표(국제엘렉트릭코리아 대표)
	산업포장		1	김현곤 상무(SK하이닉스)
	대통령표창		2	손종만 대표(지니틱스), 문주태 대표(세메스)
	국무총리표창		3	최리노 교수(인하대), 이복형 상무(미코) 이보영 상무(LG실트론)
	장관표창		28	김대성 전무(실리콘웍스) 등 28명

② 『패턴웨이퍼 지원 프로그램』 출범

□ 반도체 장비 연구개발에 필수적인 패턴웨이퍼 공급에 애로를 겪고 있는 중소 장비 기업을 위해 정부와 대기업이 손잡고 **새로운 대·중소 상생협력모델**인 **「패턴웨이퍼 지원 프로그램」을 시작한다.**

○ 패턴웨이퍼 공급을 위해서는 고가의 노광장비(대당 1천억 원대)가 필요하나, 자체 노광장비를 보유하거나 이를 공급할 인프라가 국내에 없어 영세한 국내 중소기업들은 패턴웨이퍼 확보에 애로를 겪어왔다.

○ 이 프로그램은 지난해 10월 발표된 「반도체산업 재도약 전략」의 세부과제로 그간 정부, 반도체협회, 대-중소기업 간 세부 실행방안을 마련해 '제7회 반도체의 날'을 기념해 본격적으로 출범하게 됐다.

◆ **패턴웨이퍼(Pattern Wafer)** – 고가의 노광장비를 사용해 미세한 회로 패턴이 새겨진 웨이퍼로, 개발 반도체 장비의 성능 검증을 위해 필수적



◆ **국내 중소기업의 애로 사례**

(사례1) 증착 장비기업 A사	(사례2) 열처리 장비기업 B사
개발 중인 20나노 증착장비에 대한 평가·검증을 위해 미국 반도체 전문 연구기관에 패턴웨이퍼를 주문했으나, 높은 가격과 확보까지 장시간 소요됨을 확인한 후 결국 포기함	300mm 패턴웨이퍼 조달이 어려워, 국내 연구기관을 통해 200mm를 구매하여 연구개발에 활용하고 있는 실정

□ 앞으로 국내 중, 소 장비 기업들은 세계 최고 수준의 공정기술을 가진 소자 대기업으로부터 양질의 패턴웨이퍼를 보편적이고 저렴하게 공급받게 됨으로써, 자체적으로 패턴웨이퍼 제작이 가능한 **해외 선진 장비 기업과 같은 연구개발과 성능 검증 인프라가 구축되는 효과**를 얻을 수 있다.

* 어플라이드 머트리얼즈(AMAT) 등 선진 장비 기업들은 자체적으로 패턴 웨이퍼를 제작할 수 있는 연구개발 환경이 구축되어 있어 빠른 시간 내 완성도가 높은 장비 개발이 가능

○ 패턴웨이퍼 1장 구매를 위해 수천 달러에 3개월 이상 기다려야 했던 우리 중소기업들은 앞으로 '180불에 1개월 내' 확보가 가능해졌다.

< 패턴웨이퍼 지원 프로그램 기대효과 >



□ 프로그램 운영은 반도체 협회내 운영 사무국을 설치해 중소기업으로부터 수요를 받아 소자 대기업에서 이를 제작해 적기에 공급하기로 했다.



<참고자료 1> 제7회 「반도체의 날」 기념식 개요

<참고자료 2> 정부포상 수상자 현황

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 김정화 과장(044-203-4270), 노승구 사무관(044-203-4275)에게 연락주시기 바랍니다.

참고1 제7회 「반도체의 날」 기념식 개요

□ 개최배경

○ 국가 주력 산업인 **반도체 산업의 성과와 위상을 대외에 홍보**하고, 반도체 **산·학·연의 노고를 격려**하는 **「반도체의 날」** 기념식을 개최

* '반도체 수출 100억불 달성('94.10.29)을 기념하여 제정, 2008년 1회 행사 개최

□ 개요

○ **일시/장소** : '14.10.23(목) 18:00~20:00 / 63시티 그랜드볼룸

○ **참석자** : 산업부 장관, 이현재·노영민 의원, 삼성전자 김기남 사장(협회장), SK하이닉스 박성욱 사장 등 산·학·연 관계자 500여명

□ 행사내용

구 분	시간		주요 내용
리셉션	17:00~18:00		▪ 참석자 등록 및 포토 이벤트 등
opening	18:00~18:05		▪ 오프닝 공연(미디어 퍼포먼스)
기념식	18:05~18:50		▪ 1부 기념행사
	18:05~18:07	개회 국민의례	▪ 국민의례
	18:07~18:10	개회 VIP소개	▪ 참석 내/외빈 소개
	18:10~18:15	개회 환영사	▪ 한국반도체산업협회 회장
	18:15~18:30	유공자 정부포상	▪ **정부포상(36)** - **금탑훈장(1), 동탑훈장(1), 산업포장(1), 대통령 표창(2), 국무총리 표창(3), 산업부장관 표창(28)**
	18:30~18:37	상생협력 프로그램	▪ **패턴웨이퍼 지원 프로그램 출범식**
	18:37~18:42	축 사	▪ **산업통상자원부 장관**
	18:42~18:50	유공자 민간포상	▪ 협회장상(20)
	18:50~20:00		▪ 2부 축하 리셉션
	18:50~19:00	건배사	▪ 이현재·노영민 의원, 업계 원로 등
	19:00~19:55	만 찬	▪ 축하 공연 및 만찬
	19:55~20:00	폐회선언	▪ 폐회 선언

MOTIE MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

참고2 정부포상 수상자 현황

○ **정부 포상** : 훈장(금탑1, 동탑1), 산업포장(1), 대통령표창(2), 국무총리표창(3), 산업부장관표창(28) 등 총 36점

포상 훈격	대상자	소속 및 직급	성명 (생년월일)	수공 기간	공적 개요
산업 훈장 (금탑)		삼성 에스디에스 대표이사	전동수 (58.08.01)	31년 07개월	·세계 최초 3차원 V낸드 상용화 등 '02년이후 우리 메모리산업이 세계 1위를 유지하는데 기여 ·국내 중소업체와의 상생협력을 통한 동반성장 생태계 조성
산업 훈장 (동탑)		국제엘렉트릭 코리아 대표이사	장재영 (54.11.13)	31년 04개월	·차세대 반도체 열처리 장비 개발을 통해 장비국산화율 제고 ·장비개발 및 생산을 위한 외자 유치 기여(평택)
산업 포장		SK하이닉스 상무	김현곤 (62.07.17)	23년 10개월	·고용량, 고성능(동작속도 2배 개선), 저전력(10%절감) 모바일 D램 개발 ·산학협력활동을 통한 미래 인재 육성에 기여
대통령 표창		지니틱스 대표이사	손종만 (62.06.13)	26년 08개월	·반도체 핵심 부품의 국산화율 제고 (10%→50%) 및 원가절감 70% 기여 ·터치IC 최초 국산화
		세메스 대표이사	문주태 (62.06.20)	25년 07개월	·반도체용 검사/계측장비 국산화 성공(수입대체효과 제고) ·국내 장비업계 최초로 비메모리 설비 미국시장 진출
국무 총리 표창		인하대학교 교수	최리노 (69.09.06)	20년 08개월	·미래반도체소자개발사업 기획을 통해 정부R&D사업의 새로운 패러다임 전환 기여 ·반도체 고급 인력양성에 기여
		미코 상무	이복형 (65.10.13)	23년 09개월	·반도체 장비 핵심부품인 Heater의 국산화로 대일의존도 개선 ·일본, 중국 등 해외시장 개척을 통한 반도체 부품 수출 증대
		LG실트론 상무	이보영 (59.09.20)	26년 04개월	·450mm실리콘 기판 개발 및 차세대 비메모리 기판 개발 ·태양전지용 기판 국산화 기여

포상훈격	소 속	직급	성명 (생년월일)	수공 기간	공적 개요
산업부 장관표창 (14/28)	실리콘웍스	전무 이사	김대성 (66.05.18)	14년 06개월	·디스플레이 구동 IC 세계표준화 선도 ·초저전력 IP개발 성공
	반도체협회	책임	전배근 (76.10.25)	10년 07개월	·반도체분야 우수인재 발굴 및 산/학/연/관 네트워크 구축 및 인력양성 기반구축
	SK하이닉스	수석	고승종 (68.10.07)	18년 10개월	·온실가스 배출저감 목표 달성 유공 ·대중소기업간 친환경 공급망 체계 정착
	삼성전자	부장	송승엽 (68.08.22)	19년 09개월	·반도체 後공정의 생산성 향상, 설비 국산화 및 물류 자동화 개선 등에 기여
	피에스케이	이사	송용훈 (67.01.08)	20년 01개월	·반도체 공정 Ashing 장비 국산화
	동부하이텍	상무	박현주 (60.10.15)	28년 07개월	·아날로그IC(LDI구동 반도체) 개발 성공
	이노시티	사장	이장혁 (69.10.13)	26년 07개월	·Diffusion(확산) 장비 업그레이드 원천기술 개발 확보
	실리콘화일	상무 이사	서영호 (67.04.26)	18년 03개월	·모바일용 이미지센서 자체 개발 및 상용화를 통해 중국시장 개척
	에어프로덕츠	상무 이사	김동후 (57.11.30)	30년 03개월	·반도체공정용 특수가스 및 화학재료의 국산화 성공 ·품질향상을 통한 글로벌 경쟁력 강화
	극동대학교	교수	최재성 (57.10.31)	24년 05개월	·반도체산업 인재양성 프로그램 및 교재 개발
	케이씨텍	이사	권영규 (71.11.11)	24년 06개월	·반도체공정용 CMP장비 국산화
	실리콘마이터스	연구 위원	이재우 (70.04.16)	23년 06개월	·전력관리 및 LED 구동 IC 개발
	전자부품연구원	센터장	이성철 (71.10.23)	19년 03개월	·자동차용 레이더 RFIC 및 신호처리 기술 개발과제 기획·추진 ·대·중소기업 기술협력 세미나 개최
	서경대학교	교수	임신일 (57.04.02)	33년 01개월	·차세대 신성장동력 사업 기획/추진 ·SoC설계 위원회 위원장, 국제학술대회 위원장 등 산학연 간 협력 기여

포상훈격	소 속	직급	성명 (생년월일)	수공 기간	공적 개요
산업부 장관표창 (14/28)	한국전자통신 연구원	책임	박강호 (65.03.20)	20년 00개월	·지능형 음장보안 기술 세계 최초 개발
	한양대학교	교수	박진구 (61.12.17)	20년 01개월	·반도체 제조용 CMP장비 연구개발 ·세정공정의 기술경쟁력 강화 기여
	SK하이닉스	수석	김종환 (72.09.07)	17년 03개월	·초소형 DRAM개발을 통한 효율 개선
	테스	이사	이유영 (70.10.27)	19년 05개월	·반도체 제조용 플라즈마기상증착 장비 개발
	삼성전자	수석	정희근 (70.08.27)	20년 02개월	·이미지 센서분야 16백만 센서픽셀 세계 최초 개발
	원익 아이피에스	부장	왕현철 (76.09.08)	12년 07개월	·핵심 모듈 국산화 및 이원화 개발 ·진단센서/공정분석/보상기술 개발
	한양대학교	교수	심태헌 (64.06.06)	12년 03개월	·반도체 제조공정의 응용을 통한 고효율 기판 개발(7nm급 시스템 LSI용
	앰코테크놀로지 코리아	수석	도원철 (75.09.29)	14년 02개월	·3차원 적층형 반도체 집적기술 개발
	미코에스앤피	부장	김극필 (71.07.05)	12년 07개월	·낸드플래시 테스터용 프로브카드 개발
	동부하이텍	상무	정원영 (65.07.07)	25년 09개월	·IP클라우딩 구축, 아날로그IP 발전에 기여
	SK하이닉스	수석	황성민 (66.10.17)	23년 03개월	·반도체 제조 오염제어기술 개발 ·웨이퍼캐리어 세정 장비 국산화
	삼성전자	부장	서기원 (71.01.17)	15년 5개월	·상생협력 프로그램인 반도체장비재료 성능평가사업 기획/운영
	동부하이텍	책임	정정호 (79.08.03)	16년 6개월	·200mm SMIF 장비 국산화 기여 ·핵심부품(알칼리 농도측정계) 국산화 추진
	테라세미콘	대표 이사	장택용 (59.08.25)	23년 06개월	·반도체용 열처리장비 국산화 성공

MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY